# **Pressemitteilung**

Nr.: REN0754(A)

**Renesas Synergy™ stärkt Chip-to-Cloud IoT-Konnektivität mit neuer Enterprise Cloud Toolbox**

*Neue Lösung verbindet Anwendungen schnell mit Enterprise-Cloud-Anbietern, ermöglicht Wireless-Connectivity-Evaluation zu mehreren Anbietern mit nur minimalem Aufwand und ohne Lizenzierung*

Düsseldorf, 27. Februar 2018 — Renesas Electronics Corporation (TSE: 6723), ein führender Anbieter hochmoderner Halbleiterlösungen, präsentiert die neue Renesas Synergy™ [Enterprise Cloud Toolbox v1.1](https://www.renesas.com/en-eu/search/keyword-search.html#q=Enterprise+Cloud+Toolbox&genre=sampleprogram&productlayer=188821&productlayer=188822&toollayer=300144&toollayer=189436&toollayer=189437&toollayer=189438&toollayer=189435&toollayer=400037&toollayer=400038&rows=50). Hierbei handelt es sich um ein Software-Anwendungsprojekt, das zusammen mit dem Synergy AE-CLOUD1 Kit ein Referenzdesign bietet und als Startpunkt für Anwender dient, um innerhalb von höchstens 10 Minuten eine Verbindung zu Enterprise-Clouds wie Microsoft Azure™, Amazon Web Services™ oder Google Cloud Platform™ herzustellen. Die Enterprise Cloud Toolbox spart dem Embedded-Entwickler Wochen oder sogar Monate bei der Erstellung einer sicheren End-to-End IoT-Anwendung (Internet of Things) zur Umgebungsüberwachung und -steuerung von Smart Homes, Gebäuden oder industriellen Automatisierungssystemen.

Die Enterprise-Cloud-Toolbox-Software lässt sich - anders als bei anderen Cloud Kits - per Kopieren und Einfügen in echte Projekte umsetzen. Code kann dadurch wiederverwendet werden, was die Produktentwicklung beschleunigt. Die Software umfasst Projektdateien und C-Quellcode für den Mikrocontroller (MCU) auf der Basis des Synergy Software Package (SSP) v1.3.3 sowie dem Java/JavaScript Quellcode für das Web-Dashboard. Die MCU-Software läuft auf dem zugehörigen AE-CLOUD1 Kit, das ein Synergy S5D9 Fast-Prototyping Board, ein Wi-Fi-Modul sowie einen SEGGER J-Link® Lite Debugger/Programmer enthält. Zum Start einer IoT-Anwendung lädt der Entwickler einfach das Cloud-Toolbox-Application-Projekt herunter. Dies lässt sich mit beiden Synergy-Entwicklungsumgebungen, dem e² studio oder der IAR Embedded Workbench®, zur Erstellung und Modifizierung des Quellcodes für die Embedded-MCUs sowie das Dashboard nutzen.

Mit der Enterprise Cloud Toolbox können Entwickler das in dem SSP integrierte MQTT (Message Queue Telemetry Transport) für NetX Duo™ sowie die NetX Secure™ TLS (Transport Layer Security) zur Verbindung mit dem Cloud-Anbieter ihrer Wahl nutzen. Sie können diese Verbindung auch kostenlos über einen von Renesas gehosteten Cloud-Account erstellen. Die Enterprise Cloud Toolbox erleichtert es den Anwendern, ihre Sensordaten auf einem passwortgeschützten privaten Dashboard zu visualisieren, und diese per Live-Streaming von der Synergy MCU-basierten Hardware über Ethernet oder eine Wi-Fi-Verbindung in die Cloud zu übertragen.

„Die Renesas Synergy Plattform vereinfacht die Herausforderungen beim Erstellen von End-to-End IoT-Anwendungen. Sie senkt die Einstiegshürden und verringert die Gesamtbetriebskosten“, erläutert Peter Carbone, Vice President der Synergy Platform Business Division, Renesas Electronics Corporation. „Mit unserer neuen Enterprise Cloud Toolbox und dem AE-CLOUD1 Kit können Synergy-Anwender ihre Anwendungen mit Enterprise-Cloud-Anbietern einfach verbinden und Wireless-Konnektivität ohne Lizenzgebühren evaluieren.“

Renesas zeigt die neue Enterprise Cloud Toolbox v.1.1 und das AE-CLOUD1 Kit zusammen mit weiteren neuen Synergy-Lösungen vom 27. Februar bis 1. März 2018 auf der Fachmesse [embedded world 2018](https://www.embedded-world.de/en/ausstellerprodukte) in Nürnberg an seinem Messestand (Halle 1, Stand 310).

**Über die Renesas Synergy Plattform**

Die Synergy Plattform ist die erste qualifizierte, umfassend gewartete und unterstützte Software- und Hardware-Plattform, die die Markteinführungszeit verkürzt, die Gesamtbetriebskosten verringert und die üblichen Hindernisse beseitigt, mit denen sich Entwickler beim Design ihrer IoT-Produkte konfrontiert sehen. Es ist die einzige qualifizierte Embedded-Plattform, die einen veröffentlichten Softwarequalitätsprozess auf der Grundlage internationaler Standards nutzt. Da die Entwicklung auf API-Ebene (Application Programming Interface) beginnen kann, reduziert Renesas damit die Komplexität bei der Entwicklung von sicheren, verbundenen Geräten und HMI-Systemen mit grafischen Benutzeroberflächen (GUI) und kapazitivem Touch. Die Synergy Plattform besteht aus vollständig integrierter Software, Entwicklungswerkzeugen und einer breiten Palette an skalierbaren, auf Arm® Cortex®-M basierenden MCUs mit vollem Zugriff über die Software-APIs. Es gibt keine vorab zu entrichtenden Lizenzgebühren oder im Nachhinein anfallende Nutzungsgebühren – alles ist im MCU-Kaufpreis inbegriffen.

**Preise und Verfügbarkeit**

Die Enterprise Cloud Toolbox v.1.1 steht ab sofort kostenlos bereit unter: [www.renesas.com/cloudtoolbox](http://www.renesas.com/cloudtoolbox). Das AE-CLOUD1 Kit ist ab sofort weltweit bei den Distributionspartnern von Renesas Electronics zu einem empfohlenen Verkaufspreis von US$ 149,- erhältlich.

Weitere Informationen für einen schnellen Einstieg in die Entwicklung künftiger IoT-Konnektivitäts-Anwendungen sind verfügbar unter: <http://renesassynergy.com/kits/ae-cloud1>

Die neueste Version der Synergy Plattform steht auf der Synergy Gallery zum Download bereit unter: <http://www.renesassynergy.com/>

(Änderungen bzgl. Preise und Verfügbarkeit ohne gesonderte Benachrichtigung vorbehalten.)

###

**Über Renesas Electronics Corporation**

Renesas Electronics Corporation ([TSE: 8723](http://www.jpx.co.jp/english/)) liefert mit seinen umfassenden Halbleiterlösungen innovatives und zuverlässiges Embedded-Design. Als einer der [weltweit](https://www.renesas.com/en-hq/about/company/profile/global.html) führenden Anbieter von Mikrocontrollern, A&P- und SoC-Produkten sowie integrierten Plattformen steht Renesas für langjährige Expertise und höchste Qualität. Mit seiner breiten Lösungspalette fokussiert Renesas auf die Anwendungsbereiche Automotive, Industrie, Smart Home, Büroautomation sowie Informations- und Kommunikationstechnologie. Weitere Informationen unter: [www.renesas.com](http://www.renesas.com)

**Hinweis**

Renesas Synergy ist ein Warenzeichen der Renesas Electronics Corporation. Amazon Web Services ist ein Warenzeichen der Amazon.com, Inc. oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Google Cloud Platform ist ein Warenzeichen der Google Inc. Microsoft Azure ist ein Warenzeichen der Microsoft Corporation. SEGGER J-Link® Lite ist ein Warenzeichen der SEGGER Microcontroller GmbH & Co. KG. IAR Embedded Workbench ist ein eingetragenes Warenzeichen von IAR Systems AB. NetX Secure und NetX Duo sind Warenzeichen der Express Logic, Inc. Arm und Cortex sind eingetragene Warenzeichen der Arm Limited (oder ihrer Tochterunternehmen) in der EU und/oder anderen Ländern. Alle eingetragenen Warenzeichen oder Warenzeichen sind Eigentum ihrer entsprechenden Inhaber.

**Unternehmenskontakt für Leser- und Kundenanfragen:**

Simone Kremser-Czoer

Renesas Electronics Europe GmbH, Karl-Hammerschmidt-Str. 42, 85609 Aschheim-Dornach   
Tel.: +49 89 38070-216  
E-Mail: [simone.kremser-czoer@renesas.com](mailto:simone.kremser-czoer@renesas.com)

Web: [www.renesas.com](http://www.renesas.com)

**Agenturkontakt für weitere Presseinformationen, Bildmaterial oder Artikelanfragen:**

Alexandra Janetzko

HBI Helga Bailey GmbH (PR-Agentur), Stefan-George-Ring 2, 81929 München

Tel.: +49 89 99 38 87-32

Fax: +49 89 930 24 45

E-Mail: [alexandra\_janetzko@hbi.de](mailto:alexandra_janetzko@hbi.de)

Web: [www.hbi.de](http://www.hbi.de/)